中華民國專利公報 [19] [12]

[11]公告編號: 510149

[44]中華民國 91年 (2002) 11月11日

發明

全10頁

[51] Int.Cl ⁰⁷: H05H1/24

稱: 用於電感耦合電漿產生系統之多重線圈天線 [54]名

[22]申請日期:中華民國 88年 (1999) 06月28日 088110874 [21]申請案號:

[30]優 先 權: [31]09/106,852 [32]1998/06/30 [33]美國

[72]發明人:

吉安J・陳 美國 羅柏G・維崔普 美國 湯瑪斯 E·威克 美國

[71]申請人:

藍姆研究公司 美國

[74]代理人: 陳長文 先生

1

[57]申請專利範圍:

1.一種產生一電感耦合電漿之裝置,此 裝置包含:

- 一電漿反應密室,具有形成一電磁 場路徑進入密室的窗,以及一架構 用來將處理氣體導入密室的處理氣 體供應裝置;
- 一無線電頻率天線,包含置於該電 漿反應密室外的至少第一和第二天 線部份;
- 一無線電頻率源, 此來源耦合至天 線部份並且架構來感應天線部份內 的無線電頻率電流;

連接於第一天線部份之一第一輸入 電容器和連接於第二天線部份之一 第二輸入電容器;以及

第一和第二天線部份被繫結在一 起;

其中無線電頻率電流所感應的電磁 場會有效的通過窗,並將處理氣體 激磁並離子化,藉此在密室內產生 2

電漿;以及

其中該第一天線部份圍繞該第二天 線部份。

- 2.如申請專利範圍第1項之裝置,其中 產生的電漿之密度大致上會與該至 5. 少第一和第二天線部份圍住的區域 內之密度一樣。
- 3.如申請專利範圍第1項之裝置,其中 每個該至少第一和第二天線部份將 無線電頻率功率耦合至密室內不同 10. 的區域,導致密室內整體一致的電 漿。
 - 4.如申請專利範圍第1項之裝置,其中 至少第一和第二天線部份是由單圈 線圈所製成。
 - 5.如申請專利範圍第1項之裝置,其中 第一天線部份由單圈線圈所製成, 第二天線部份由多圈線圈所製成。
- 6.如申請專利範圍第1項之裝置,其中 至少第一和第二天線部份是由多圈 20.

15.

10.

25.

動。

3

線圈所製成。

- 7.如申請專利範圍第1項之裝置,進一步包含至少一用於調整該至少第一和第二天線部份內電流的輸入調整電容器,如此可讓電流平等或不平等。
- 8.如申請專利範圍第7項之裝置,其中至少一輸入調整電容器可在每個天線部份內提供較高的電流,導致較高的無線電頻率功率耦合至相鄰於天線部份的電漿區域,或在每個天線部份內提供較低的電流,導致較低的功率耦合至該電漿區域。
- 9.如申請專利範圍第7項之裝置,其中 一對輸入電容器用於調整一對天線 部份內的電流,並且配置成用單一 控制裝置以反方向旋轉。
- 10.如申請專利範圍第1項之裝置,其 中至少第一和第二天線部份由單一 無線電頻率電源供電,並且由單一 匹配網路調整。
- 11.如申請專利範圍第1項之裝置,其 中第一和第二天線部份的輸出端會 連接在一起並透過一阻抗終止至接 地。
- 12.如申請專利範圍第1項之裝置,其 中第一和第二天線部份透過個別的 固定或可變電容器終止至接地。
- 13.如申請專利範圍第12項之裝置,其 中每個輸出電容器可沿著每個天線 部份調整極端電流或極端電壓的位 置。
- 14.如申請專利範圍第12項之裝置,其中第一和第二天線部份內最大電流的位置是第一天線部份相對於第二天線部份的旋轉位置之函數;以及其中該輸出電容器進一步調整該位置,如此最大電流位置大約會離開180度方位角,處於輻射狀的相對位置上,因此可顯著降低由於方位角

4

- 不一致電流分佈所產生的電漿方位角不一致。
- 15.如申請專利範圍第12項之裝置,其中一對輸出電容器調整第一和第二 天線部份內的電流,並且配置成用 單一控制裝置以反方向旋轉。
 - 16.如申請專利範圍第1項之裝置,其 中第一和第二天線部份架構成共平 面的二維架構、不共平面的三維架 構或兩者的組合。
 - 17.如申請專利範圍第1項之裝置,其中第一和第二天線部份會配置成一個天線部份直徑比另一個天線部份還小的同心圓。
- 15. 18.如申請專利範圍第16項之裝置,其 中該三維架構維圓頂或螺旋架構其 中之一。
 - 19.如申請專利範圍第1項之裝置,其中該天線部份大約是圓形的形狀。
- 20. 20.如申請專利範圍第1項之裝置,其 中該至少第一和第二天線部份貼附 於密室窗外部表面附近。
 - 21.如申請專利範圍第1項之裝置,其 中第一和第二天線部份內的電流會 繞著該部份以相同的方位角方向流
 - 22.一種產生一電感耦合電漿之裝置, 此裝置包含:
- 一電漿反應密室,具有形成一電磁 30. 場路徑進入密室的窗,以及一架構 用來將處理氣體導入密室的處理氣 體供應裝置;
 - 一無線電頻率天線,包含置於該電 漿反應密室外的至少第一和第二多 圈天線部份;
 - 一無線電頻率源,此來源耦合至天 線部份並且架構來感應天線部份內 的無線電頻率電流;
- 連接於第一天線部份之一第一輸入 40. 電容器和連接於第二天線部份之一

35.

5

第二輸入電容器;以及

第一和第二天線部份被繫結在一 起;

其中無線電頻率電流所感應的電磁 場會有效的通過窗,並將處理氣體 激磁並離子化,藉此在密室內產生 電漿;以及

其中該第一多圈天線部份為圍繞該 第二多圈天線部份的外側線圈。

- 23.如申請專利範圍第22項之裝置,其中產生的電漿之密度大致上會與該至少第一和第二多圈天線部份圍住的區域內之密度一樣。
- 24.如申請專利範圍第22項之裝置,其中每個該至少第一和第二天線部份將無線電頻率功率耦合至密室內不同的區域,導致密室內整體一致的電漿。
- 25.如申請專利範圍第22項之裝置,其 中第一多圈天線部份架構成一平面 多圈線圈,而第二多圈天線部份具 有第一和第二部分。
- 26.如申請專利範圍第25項之裝置,其中第二多圈天線的該第一部分將架構成一平面式多圈線圈,並且第二多圈天線部份的該第二部分則架構成一螺旋線圈。
- 27.如申請專利範圍第26項之裝置,其中該第二部分進一步在該螺旋線圈內包含一中空介質圓柱體,而中空介質圓柱體的中空部份直接連接至處理密室。
- 28.如申請專利範圍第27項之裝置,其 中將螺旋線圈和中空介質圓柱體架 構成允許電漿在密室內低壓的情況 下激發,導致增加處理密室中央內 的電漿密度。
- 29.如申請專利範圍第22項之裝置,其 中第一多圈天線部份具有一第一平 面式部份和一第二非平面式部份,

6

- 而第二多圈天線部份則具有一第一 平面式部份和一第二非平面式部 份。
- 30.如申請專利範圍第29項之裝置,其 5. 中第一多圈天線部份的該第二部分 架構為螺旋線圈。
 - 31.如申請專利範圍第29項之裝置,其中第二多圈天線部份的該第二部分架構為螺旋天線。
- 10. 32.如申請專利範圍第22項之裝置,其 中第一多圈天線部份的總長度與第 二多圈天線部份的總長度相當,所 以天線部份內的電流可有較大的調 整範圍。
- 15. 33.如申請專利範圍第22項之裝置,進一步包含至少一用於調整該至少第一和第二天線部份內電流的輸入調整電容器,如此可讓電流平等或不平等。
- 20. 34.如申請專利範圍第33項之裝置,其中至少一輸入調整電容器可在每個天線部份內提供較高的電流,導致較高的無線電頻率功率耦合至相鄰於天線部份的電漿區域,或在每個
 25. 天線部份內提供較低的電流,導致較低的功率耦合至該電漿區域。
 - 35.如申請專利範圍第33項之裝置,其 中一對輸入電容器用於調整一對天 線部份內的電流,並且配置成用單 一控制裝置以反方向旋轉。
 - 36.如申請專利範圍第22項之裝置,其 中至少第一和第二天線部份由單一 無線電頻率電源供電,並且由單一 匹配網路所調整。
- 35. 37.如申請專利範圍第22項之裝置,其中第一和第二天線部份透過個別的固定或可變電容器終止至接地。
 - 38.如申請專利範圍第37項之裝置,其 中每個輸出電容器可沿著每個天線 部份調整極端電流或極端電壓的位

40.

30.

7

置。

- 39.如申請專利範圍第37項之裝置,其中第一和第二天線部份內最大電流的位置是第一天線部份相對於第二天線部份的旋轉位置之函數;以及其中該輸出電容器進一步調整該位置,如此最大電流位置大約會離開180度方位角,處於輻射狀的相對位置上,因此可顯著降低由於方位角不一致電流分佈所產生的電漿方位角不一致。
- 40.如申請專利範圍第37項之裝置,其 中一對輸出電容器調整第一和第二 天線部份內的電流,並且配置成用 單一控制裝置以反方向旋轉。
- 41.如申請專利範圍第26項之裝置,其中一輸出電容器用來將最大電流的位置移動至第二多圈天線部份的第一部分或第二部分,導致由多圈天線部份到電漿的功率耦合改變。
- 42.如申請專利範圍第30項之裝置,其中一輸出電容器用來將最大電流的位置移動至第二多圈天線部份的第一部分或第二部分,導致由多圈天線部份到電漿的功率耦合改變。
- 43.如申請專利範圍第31項之裝置,其中一輸出電容器用來將最大電流的位置移動至第二多圈天線部份的第一部分或第二部分,導致由多圈天線部份到電漿的功率耦合改變。
- 44.如申請專利範圍第41項之裝置,進一步包含一隨附該輸出電容器的輸入電容器,其中調整輸入電容器導致無線電頻率的總輸入阻抗維持不變,允許一多圈天線部份內的電流不會影響到其他多圈天線部份內的電流。
- 45.如申請專利範圍第42項之裝置,進一步包含一隨附該輸出電容器的輸入電容器,其中調整輸入電容器導

8

- 致無線電頻率的總輸入阻抗維持不 變,允許一多圈天線部份內的電流 不會影響到其他多圈天線部份內的 電流。
- 46.如申請專利範圍第43項之裝置,進一步包含一隨附該輸出電容器的輸入電容器,其中調整輸入電容器導致無線電頻率的總輸入阻抗維持不變,允許一多圈天線部份內的電流不會影響到其他多圈天線部份內的電流。
- 47.如申請專利範圍第22項之裝置,其中第一和第二天線部份會配置成一個天線部份直徑比另一個天線部份 15. 還小的同心圓。
 - 48.如申請專利範圍第22項之裝置,其 中該至少第一和第二天線部份貼附 於密室窗外部表面附近。
- 49.如申請專利範圍第22項之裝置,其 20. 中第一和第二天線部份內的電流會 繞著該部份以相同的方位角方向流 動。
 - 50.一種產生一電感耦合電漿之裝置, 此裝置包含:
- 25. 一電漿反應密室,具有形成一電磁 場路徑進入密室的窗,以及一架構 用來將處理氣體導入密室的處理氣 體供應裝置;
- - 一無線電頻率源,此來源耦合至天 線部份並且架構來感應天線部份內 的無線電頻率電流;
- 35. 連接於天線部份一第一部份之一第 一輸入電容器和連接於天線部份一 第二部份之一第二輸入電容器;以 及

兩天線部份被繫結在一起;

40. 其中無線電頻率電流所感應的電磁

15.

20.

9

電?

場會有效的通過窗,並將處理氣體 激磁並離子化,藉此在密室內產生 電漿;以及

其中兩天線部份彼此分隔並且就兩 天線部份之間之一中央軸彼此平 衡。

- 51.如申請專利範圍第50項之裝置,其中每個天線部份為 D 形並架構成一半圓以及一沿著其直徑的直線。
- 52.如申請專利範圍第51項之裝置,其 中該天線部份的直線與另一個天線 的直線平行並涵蓋窗的中央區域, 導致環繞中央軸對稱的電漿密度。
- 53.如申請專利範圍第50項之裝置,其 中兩天線部份的輸入端會連接在一 起,兩天線部份的輸出端也連接在 一起並透過一可變電容器終止於接 地。
- 54.如申請專利範圍第51項之裝置,其 中兩天線部份直線內的電流會以相 同方向流動。
- 55.如申請專利範圍第50項之裝置,其中天線部份由單一無線電頻率電源供電並由單一匹配網路調整。
- 56.如申請專利範圍第50項之裝置,其 中產生的電漿之密度大致上會與該 天線部份圍住的區域內之密度一 樣。
- 57.如申請專利範圍第50項之裝置,其中每個該天線部份將無線電頻率功率耦合至密室內不同的區域,導致密室內整體一致的電漿。
- 58.如申請專利範圍第50項之裝置,其 中該天線部份貼附於密室窗外部表 面附近。
- 59.一種用於電漿反應密室之電感耦合電漿天線系統,包含: 第一和第二同心圓天線部份,其作為彼此相隔之同心圓電流路徑; 連接於第一天線部份之一第一輸入

電容器和連接於第二天線部份之一 第二輸入電容器;以及

10

第一和第二天線部份被繫結在一 起;

- 5. 其中鄰近第一和第二同心圓天線部份之部位內的電流係以相同的方向流動。
- 60.如申請專利範圍第59項之系統,其中同心圓電流路徑將無線電頻率功10. 率耦合至密室內徑向和方位角不同的區域,並在密室內合作提供一致的電漿分配。
 - 61.如申請專利範圍第59項之系統,其中同心圓電流路徑架構成共平面二維架構、不共平面三維架構或兩者的組合。
 - 62.一種處理半導體介質的過程,此過程以申請專利範圍第1項之裝置內形成的電漿來接觸半導體介質的外露表面。
 - 63.一種處理一半導體介質之過程,此 過程以申請專利範圍第22項之裝置 內形成的電漿來接觸半導體介質的 外露表面。
- 25. 64.一種處理一半導體介質之過程,此 過程以申請專利範圍第50項之裝置 內形成的電漿來接觸半導體介質的 外露表面。
- 65.一種處理一半導體介質之過程,此30. 過程以申請專利範圍第 59 項之裝置 內形成的電漿來接觸半導體介質的 外露表面。

圖式簡單說明:

圖1說明電漿反應器,其中天線 35. 系統位於介質窗的頂端並且用於將無 線電頻率能量耦合入處理室;

圖 2A 和 2B 說明兩個傳統的螺旋線圈天線;

圖 3 依照本發明的第一具體實施 40. 例,說明一個雙單圈平面式線圈排列

-5665 -

5.

11

方式的範例;

圖 4 依照本發明的第二具體實施 例,說明一個雙多圈平面式線圈排列 方式的範例;

圖 5 依照本發明的第三具體實施 例,說明一個具有螺旋線圈的雙多圈 平面式線圈排列方式之範例; 12

圖 6 依照本發明的第四具體實施例,說明一個具有內側和外側螺旋線圈的雙多圈平面式線圈排列方式之範例;及

圖7依照本發明的第五具體實施 例,說明一個具有平行天線元件的雙 多圈平面式線圈排列方式之範例;

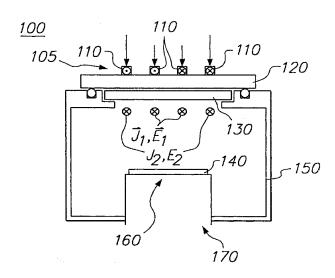
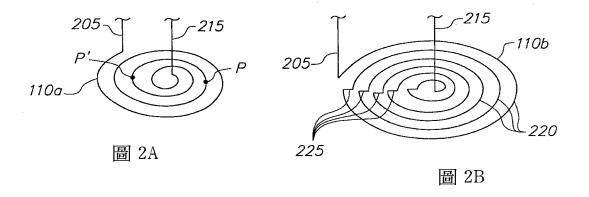
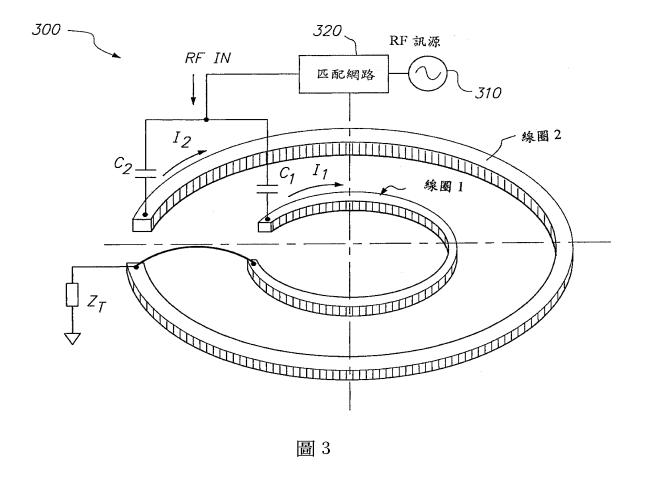
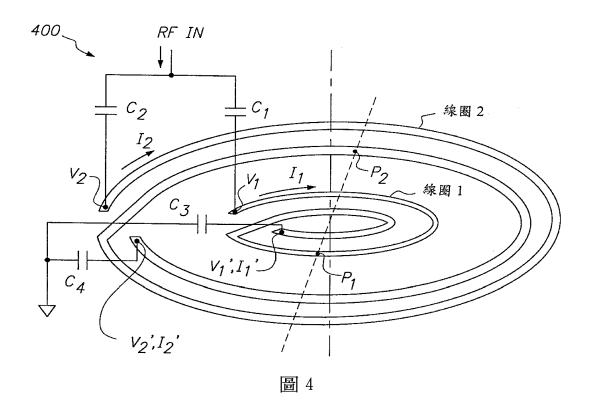
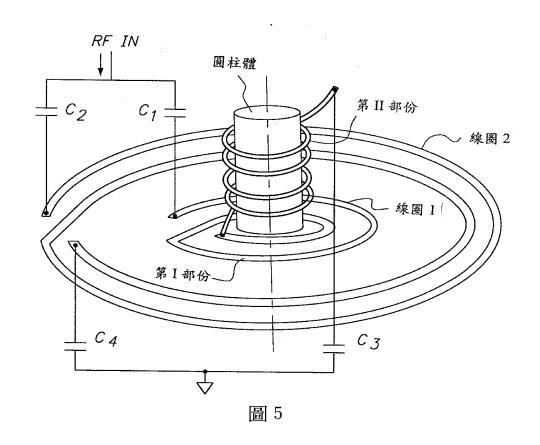


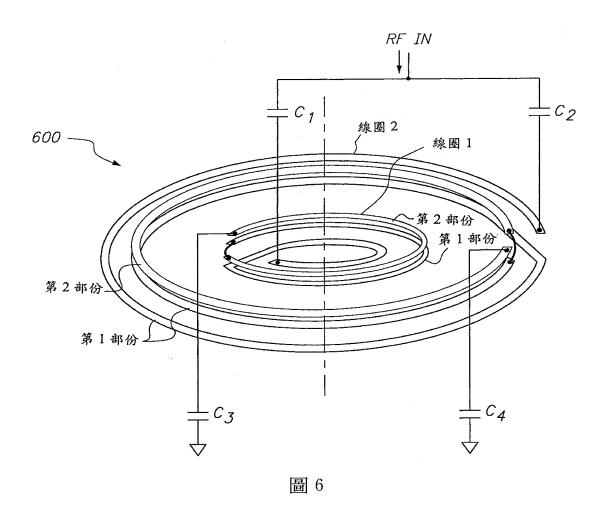
圖 1











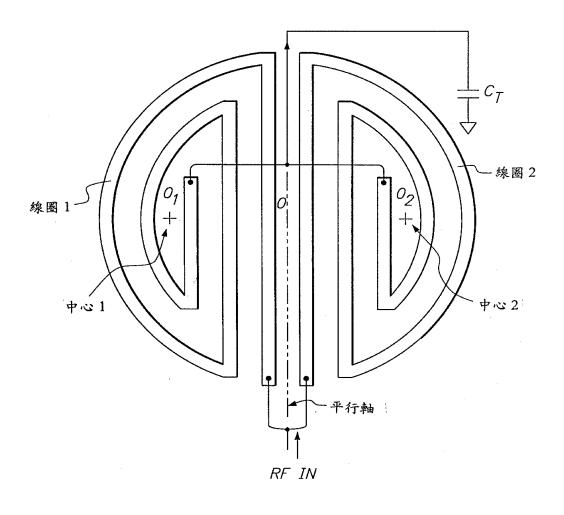


圖 7